



BOA1310070YY300MXXXX 光纤耦合增强半导体光放大器



产品特点

- 高输出功率 >300mW @ 1300nm
- 高饱和输出功率 (20dBm)
- 专有防反射涂层技术，可靠性高
- 保偏 PM980 (PM1300 可选) 光纤或 HI1060 光纤
- 900um 光纤松套管 (可选)

产品应用

- LiDAR
- 数据通讯
- 扫频光源，可调谐激光器
- 光学相干断层扫描 (OCT)

推荐操作条件

@ CW, Tcase=25°C

参数	Min. 值	典型值	Max. 值	单位
芯片温度	20	25	40	°C
正向电流		2000	3000	mA
放大模式下的输出功率			300	mW
输入光功率	-20	10	15	dBm



增益特性

@ CW, 25°C, 2000mA, 输入信号 10dBm, 1300nm

参数	Min. 值	典型值	Max. 值	单位
正向电流@350mW			3000	mA
饱和输出功率@-3dB	16	20		dBm
增益	12	16		dB
小信号增益@Pin=-25dBm	33	37		dB
峰值波长	1295	1310	1320	nm
带宽@-3dB		70		nm
噪声系数@Pin=-20dBm		6		dB

放大自发辐射(ASE)特性

@CW, 25°C, 2000mA, 无输入信号

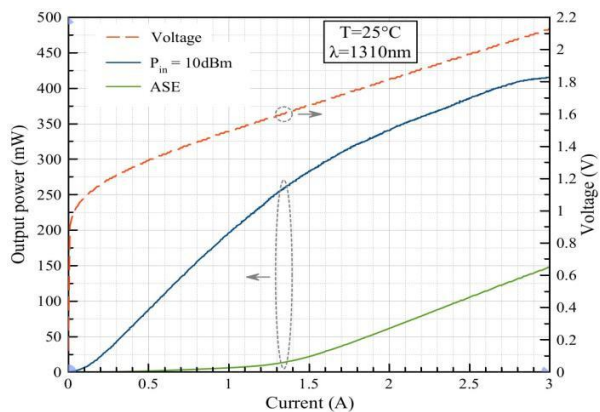
参数	Min. 值	典型值	Max. 值	单位
输出功率 (每个端口)		70		mW
正向电压		1.8	2.3	V
平均波长		1230		nm
带宽 (FWHM)		16		nm
纹波** (RMS)		0.02	1	dB
偏振消光比 (PER)	14	16		dB
偏振		TE		

** - 以 20pm 分辨率在光谱最大值附近 1nm 范围内测量

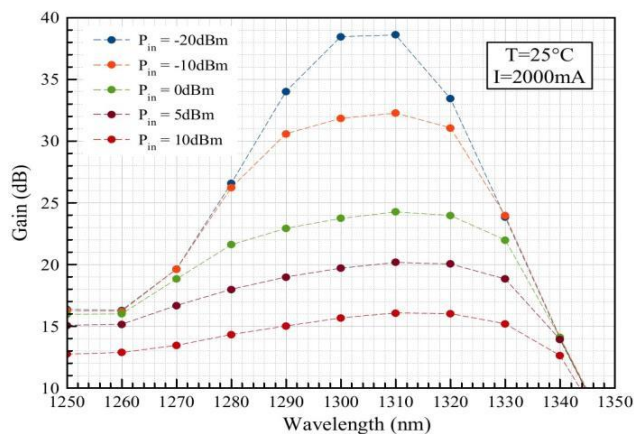
典型性能 (仅供参考)

@ CW, Tcase=25°C

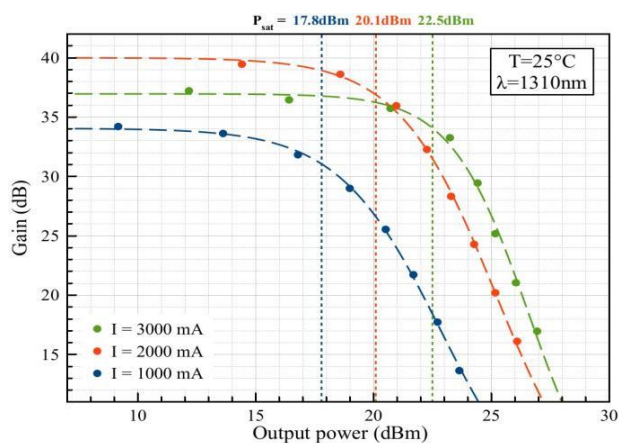
输出功率 vs 工作电流



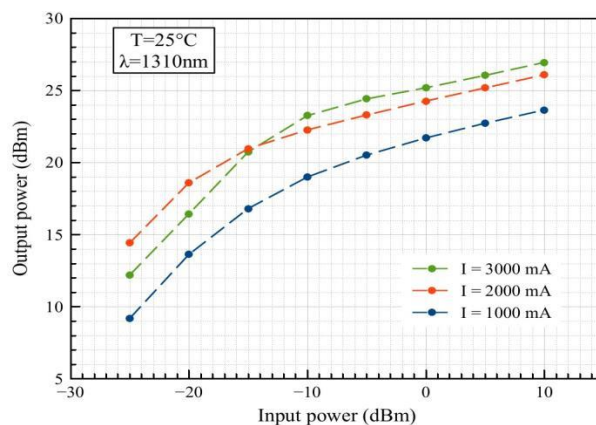
增益谱线



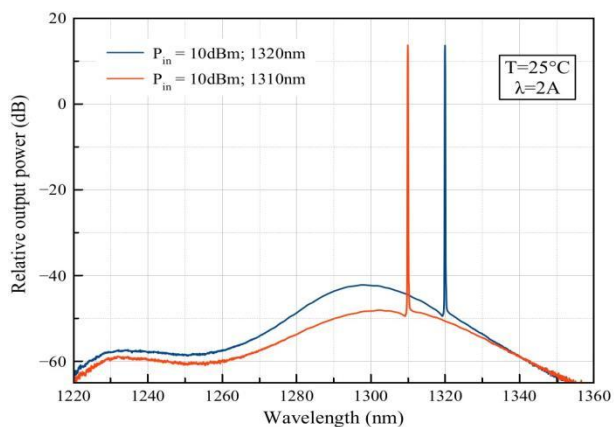
增益 vs 输出功率



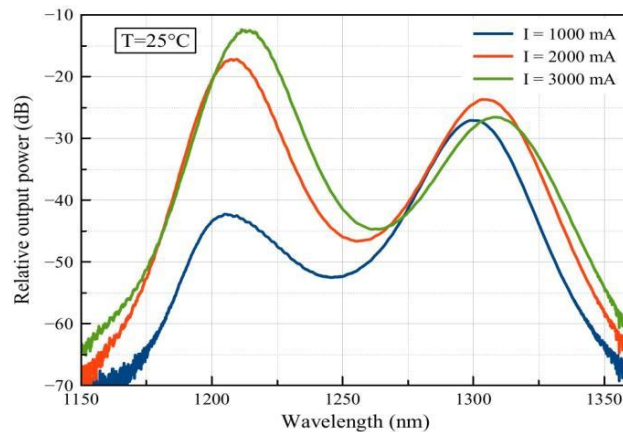
输出功率 vs 输入功率



放大光信号的光谱



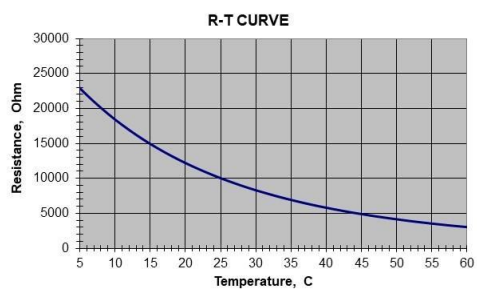
光谱(ASE)

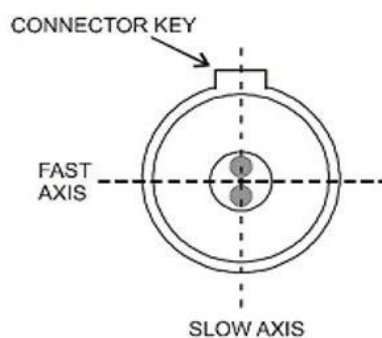




绝对最大额定参数

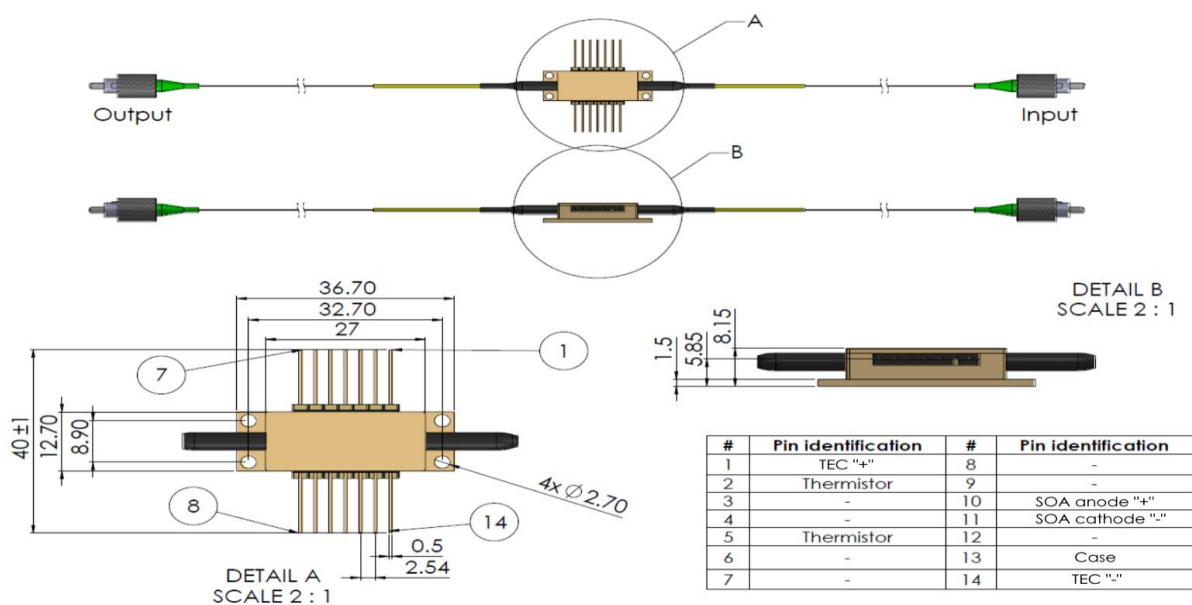
参数	Min. 值	Max. 值	单位
输出光功率		800	mW
输入光功率		20	dBm
正向电流		3500	mA
反向电压		2	V
TEC 电流		3	A
TEC 电压		4	V
芯片工作温度	5	50	°C
外壳箱体工作温度	0	50	°C
存储温度	0	50	°C
引脚焊接温度 (最长 10 秒, 最高外壳温度 120°C)		300	°C
光纤带半径	3		cm

热敏电阻规格			光纤规格			
参数	值	单位	参数	值	值	单位
类型	NTC		光纤类型	HI1060	PM980	
电阻@25°C	10±0.1	kOhm	数值孔径 (典型值)	0.14	0.12	
Beta 25-85°C	3435±1%	K	截止波长	920±50	900±70	nm
			模场直径	6.2±0.3 @1060nm	6.6±0.3 @1060nm	μm
			包层直径	125±1	125±1	μm
			涂层直径	245±15	245±15	μm
			松套管直径 (可选)	900	900	μm
			连接器	FC/APC	FC/APC	
			键	narrow	narrow	



The output light is polarized along the slow axis of PM fiber.

尺寸（单位：毫米）





安全和操作说明

此设备发出的光是不可见的，对人眼有害。设备运行时，请避免直视光纤连接器。在连接器打开的情况下操作时，必须佩戴适当的激光安全眼镜。

绝对最大额定值仅可短时间应用于设备。长时间暴露于最大额定值或暴露于多个最大额定值可能会导致设备损坏或影响设备的可靠性。在设备的最大额定值之外操作设备可能会导致设备故障或安全隐患。必须使用与组件一起使用的电源，以使最大正向电流不超过。

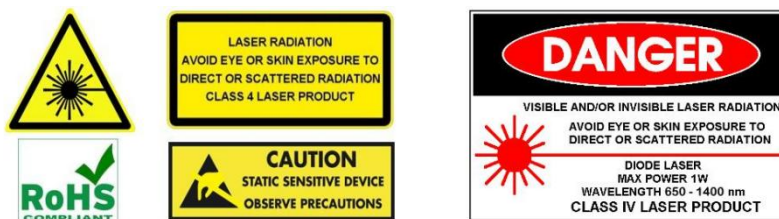
热辐射器上的设备需要适当的散热器。必须使用 4 个螺钉（以 X 型螺栓拧紧，初始扭矩设置为 0.075Nm，最终以 X 型螺栓拧紧，扭矩设置为 0.15Nm）或夹具将设备安装在散热器上。散热器表面的平整度偏差必须小于 0.05mm。建议在外壳底部和散热器之间使用铟箔或导热柔软材料作为热界面。不宜为此使用导热油脂。

避免设备背反射。它可能会影响设备在光谱和功率稳定性方面的性能。

还可能导致致命的面损坏。强烈建议使用光隔离器来阻挡背反射。

不要拉动光纤。不要弯曲半径小于 3 厘米的光纤。在安装过程中，应始终保护光纤尖端免受任何污染或损坏。取下光纤尖端的防尘盖后，使用沾有异丙醇或乙醇的光学镜头清洁纸或棉签沿一个方向擦拭，小心清洁光纤尖端。仅使用干净的光纤连接器操作设备。

ESD 保护 - 静电放电是产品意外故障的主要原因。采取极端预防措施以防止 ESD。在设备安装过程中，必须保持 ESD 保护 - 在处理产品时使用腕带、接地的工作表面和严格的防静电技术。



型号识别

BOA1310070HI300MXXXX -> 1310nm 平均波长下输出功率为 300mW，带宽为 70nm，HI-1060 光纤

BOA1310070PM300MLXXX -> 1310nm 平均波长下输出功率为 300mW，带宽为 70nm，PM-980 光纤，带松套管